

武汉金运激光股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司日常运营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

- 1、公司拟向银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度。
- 2、具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）后续进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
- 3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。
- 4、公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

2017年4月24日公司董事会三届二十四次会议已审议通过向银行申请人民币6,000万元综合授信额度的议案(详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告),截至2018年4月11日,公司实际累计使用贷款金额为人民币2,350.78万元,未使用完的授信额度不再使用。此次董事会同意公司重新申请不超过人民币5,000万元授信额度,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.54%。

截至2018年4月11日,公司累计授信和借款金额为人民币12,200万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为50.11%。

本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2018年4月13日